

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	广发证券、西南证券、招商证券、国寿资产、新华资产、工银瑞信基金、易方达基金、摩根士丹利等。
时间	2023年2月3日-2月10日
地点	电话会议；深圳市南山区侨城东路99号深南电路股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务整体规划布局情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，在不断强化 PCB 业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务，形成业界独特的“3-In-One”业务布局。公司业务覆盖 1 级到 3 级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供一站式综合解决方案。</p> <p>分业务下游领域看，公司 PCB 业务产品下游以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域；电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，公司主要聚焦通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域；封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。</p>

Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。在国内通信市场需求放缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备良好发展前景。

Q3、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年前三季度，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模同比增长。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2022 年第三季度以来，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压。

Q4、请介绍公司 PCB 业务进入数据中心领域的竞争优势。

公司凭借在通信等传统优势领域积累的工艺技术能力和研发能力，能够满足目前市场对数据中心产品的技术要求，同时，伴随 5G 时代对信息传输速度以及传输容量的需求提升，数据中心硬件也持续向高速、大容量的方向发展，其对 PCB 在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面有着更高要求。公司在高速、高频等方面的技术优势可进一步得到延伸。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2022 年前三季度，伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子营收规模同比实现较大增长，但占 PCB 整体营收比重相对较小。目前，汽车电子领域订单保持稳定

增长。

Q6、请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及未来展望。

与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。未来伴随车联网等终端应用的涌现，汽车也可能成为新型的移动终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

Q7、请介绍公司汽车电子 PCB 南通三期工厂产能爬坡进展。

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到四成以上。

Q8、请介绍公司布局电子装联业务的策略。

公司于 2008 年进入电子装联领域，旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。公司电子装联业务按照产品形态包括 PCBA 板级、功能性模块、部分整机产品/系统总装等，目前已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力，主要聚焦通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域，业务多年来保持稳定发展。

Q9、请介绍公司封装基板业务近期下游市场需求情况。

受全球消费电子市场需求回落影响，公司部分应用于消费领域的封装基板产品需求下降，存储等非消费类应用领域的封装基板产品需求相对稳健。2022 年第三季度以来，公司封装基板工厂产能利用率较 2022 年上半年有所下降。

Q10、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。

公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（半导体垂直整合制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）厂商。

	<p>Q11、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。</p> <p>相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升。</p> <p>Q12、请介绍广州封装基板项目建设进展及预计连线时间。</p> <p>公司广州封装基板项目共分两期建设，目前项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设，预计将于 2023 年第四季度连线投产。</p> <p>Q13、请介绍广州封装基板项目目标产品及相关研发进展。</p> <p>公司广州封装基板项目主要面向 RF、FC-CSP 及 FC-BGA 封装基板，其中 RF、FC-CSP 封装基板均为公司相对成熟产品，并已在现有工厂实现批量化生产，FC-BGA 封装基板研发按计划推进，目前已有部分产品向客户进行送样验证。</p> <p>Q14、请介绍公司近期原材料采购价格变化情况。</p> <p>受大宗商品及供需关系变化影响，2022 年覆铜板等主要原材料整体价格同比有所下降；化学品价格有所提升，但占原材料比重较小。目前，公司原材料价格整体保持稳定。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 2 月 14 日